06;07

Фотоэлектрический преобразователь нового типа на основе гетероструктуры *n*-CdO/*a*-C/*p*-Si

© А.М. Баранов, Ю.А. Малов, С.А. Терешин

Государственный научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского, Москва

Поступило в Редакцию 17 апреля 1997 г.

Предлагается новая схема фотоэлектрического преобразователя и на примере гетероструктуры n-CdO/a-C/p-Si исследуются ее фотоэлектрические свойства. Отличительной особенностью структуры является то, что широкозонный диэлектрический слой SiO₂ на поверхности кремния заменен на узкозонный слой аморфного углерода, а в качестве верхнего электрода использован слой CdO.

Показано, что в подобной гетероструктуре можно ожидать увеличение тока короткого замыкания вследствие ударной ионизации. Результаты работы позволяют сделать вывод о целесообразности практического использования пленок CdO в качестве прозрачных электродов.

В последнее время все более важной становится задача получения экологически чистой электроэнергии за счет преобразования солнечного излучения. Поэтому создание и исследование новых материалов и способов прямого преобразования света в электроэнергию представляется весьма актуальным, учитывая, что для самого широко используемого в солнечной энергетике материала-кремния уже почти достигнут предел по эффективности [1–3].

В работе предлагается новая схема фотоэлектрического преобразователя, позволяющая увеличить ток короткого замыкания благодаря как

1

созданию условий для ударной ионизации, так и увеличению внутреннего квантового выхода преобразователя в коротковолновой области.

Схема энергетической зонной диаграммы преобразователя показана на рис. 1. Суть предлагаемой схемы фотоэлектрического преобразователя состоит в следующем. При формировании элемента между двумя слоями *p*-(П1) и *n*-(П3) типа, имеющими разную ширину запрещенной зоны, располагают промежуточный полупроводниковый слой (П2), в котором имеется сильное электрическое поле. Назначение слоя обеспечить разогрев носителей заряда и их перенос без рассеяния между слоями *n*- и *p*-типа. При этом фотогенерируемые носители могут приобрести энергию, достаточную для ударной ионизации, что приведет к дополнительной генерации носителей заряда.

Для того чтобы обеспечить выполнение этих условий, параметры слоев гетероструктуры должны быть выбраны исходя из следующих соображений.

Ширина запрещенной зоны (E_{g3}) слоя ПЗ, на который падает солнечный свет, должна быть больше, чем E_{g1} , чтобы обеспечить эффект "окна". В данном преобразователе слой ПЗ сформирован на основе полупроводника с $E_{g3} \approx 2.5$ eV. В солнечном спектре есть кванты света с энергией $E > E_{g3}$, которые будут поглощаться в слое ПЗ. Кванты света с $E < E_{g3}$ проходят через слой 3 и если их энергия будет больше E_{g1} , поглощаются в слое П1. Ширина запрещенной зоны E_{g3} выбрана такой, чтобы неосновные носители, двигаясь из ПЗ в П1, приобретали на границе раздела ПЗ–П2 энергию, достаточную для ударной ионизации в слое П1.

Условия возникновения ударной ионизации обеспечиваются при выполнении соотношения $(3/2)E_{g1} < E_{g3} - \eta_1 - U_1$, в котором U_1 — напряжение, соответствующее изгибу зон в П1; η_1 — разность между энергией Ферми и энергией потолка валентной зоны в П1.

Чтобы уменьшить последовательное сопротивление преобразователя (а следовательно, увеличить фактор заполнения) и увеличить собирание носителей, слой ПЗ может быть выполнен на основе сильнолегированного полупроводника. Кроме того, толщина слоя ПЗ выбирается такой, чтобы он являлся антиотражающим покрытием к слою П1. Следовательно, полупроводниковый слой ПЗ является:

– антиотражающим покрытием от отношению к слою П1,

— собирающим носители заряда с поверхности преобразователя,

— генерирующим электрон-дырочные пары за счет поглощения света в "синем" диапазоне видимого солнечного спектра.



Рис. 1. Схема энергетической зонной диаграммы.

Данная структура похожа на МДП-структуру наличием в ней тонкого промежуточного слоя П2 между слоями П1 и П3. Наличие тонкого диэлектрического слоя в структуре металл–диэлектрик–полупроводник позволяет увеличить напряжение холостого хода $V_{\rm xx}$ по сравнению с барьером Шоттки за счет встроенного положительного заряда [4]. В то же время этот слой (в любом случае) препятствует движению носителей заряда из-за наличия потенциального барьера на границе слоев. Поэтому в рассматриваемой структуре широкозонный диэлектрический слой заменен на узкозонный полупроводниковый слой. Параметры слоя П2 должны быть такими, чтобы обеспечить перенос носителей заряда через него в баллистическом режиме (т. е. длина свободного пробега носителей в слое П2 должна быть больше толщины слоя, а $E_{g2} < E_{g1}$). Таким образом, соотношение между запрещенными зонами слоев следующее: $E_{g3} > E_{g1} > E_{g2}$.



Рис. 2. Вольт-амперная характеристика структуры *n*-CdO/*a*-C/*p*-Si при освещении солнечным светом интенсивностью $0.1 \text{ W/cm}^2(a)$ и зависимости коэффициента отражения (*R*) от длины волны для ФЭП и для чистого кремния (*b*).

Особенность физических процессов, лежащих в основе функционирования предлагаемого преобразователя, заключается в следующем. Скачки потенциалов на границах раздела между П1 и П2 и между П2 и П3 обеспечивают разогрев электронов и дырок. Если при пролете слоя П2 горячие баллистические электроны и дырки не испытывают

рекомбинации или рассеяния, то дырки, входя в слой П1, имеют энергию, достаточную для генерации электронно-дырочных пар. Это приводит к увеличению тока короткого замыкания.

При создании фотоэлектрического преобразователя мы исходили из имеющихся в нашем распоряжении материалов и технологий. Поэтому в качестве материала слоя П1 был выбран кремний с дырочной проводимостью (КДБ-10). Толщина пластины составляла 330 µm, $E_{g1} = 1.1 \text{ eV}$. Промежуточный слой П2 выполнен из аморфного углерода (a-C) толщиной 30 A и $E_{g2} = 0.5$ eV. Толщина *a*-C контролировалась непосредственно в процессе осаждения [5,6]. В качестве второго крайнего слоя П1 *п*-типа был взят широкозонный полупроводник CdO с шириной запрещенной зоны 2.5 eV [7,8] и толщиной приблизительно 800 А. Слои аморфного углерода были получены магнетронным распылением графита в аргоне, а CdO в атмосфере азота с кислородом. Активная площадь фотоэлектрического преобразователя составляла $S = 0.64 \, \text{cm}^2$. Слой CdO состоял из двух областей с разным удельным сопротивлением. Первая область (вблизи границы раздела ПЗ-П2) шириной 100 A имела удельное сопротивление $\approx 1\Omega \cdot cm$, а вторая $ho = 5 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot \mathrm{cm}$. Изменение удельного сопротивления было осуществлено за счет изменения концентрации кислорода в CdO [8]. Создание двух областей было вызвано необходимостью ввести тянущее электрическое поле внутрь слоя CdO с тем, чтобы увеличить сбор носителей заряда, генерированных в CdO.

На рис. 2, *а* показана вольт-амперная характеристика структуры *n*-CdO/*a*-C/*p*-Si при освещении солнечным светом интенсивностью 0.1 W/cm². Видно, что, несмотря на небольшое $V_{xx} = 0.32$ V, ток короткого замыкания соответствует значениям, полученным у лучших солнечных элементов на основе кремния [1,2]. КПД структуры составляет ~ 11.5%. При отсутствии слоя *a*-C ток короткого замыкания был в несколько раз меньше, что, возможно, связано с высокой плотностью пограничных состояний. На рис. 2, *b* показаны зависимости коэффициента отражения (*R*) от длины волны для данной структуры (кривая *I*) и для чистого кремния (кривая *2*). Видно, что *R* практически равен 0 на длине волны 800 nm.

Из сказанного выше следует, что, несмотря на неоптимальность описанной экспериментальной гетероструктуры, она показывает перспективность предложенной схемы фотоэлектрического преобразователя для дальнейших исследований.

Список литературы

- [1] Gtauvogl M., Aberle A.G. et al. // Appl. Phys. Lett. 1996. V. 69. P. 1462-1464.
- [2] Zhao J., Wang A. et al. // Appl. Phys. Let. 1996. V. 66. N 26. P. 3636-3638.
- [3] Solar Cells and Their Industrial Application // Advances in aterials Technology: Monitor, UNIDO. 1993. Issue N 31. P. 2–36.
- [4] Зи С. Физика полупроводниковых приборов.
- [5] Baranov A., Tereshin S., Mikhailov I. et al. // Proc. SPIE. 1996. V. 2863. P. 359– 367.
- [6] Baranov A., Tereshin S., Mikhailov I. et al. Proc. SPIE. 1995. V. 2519. P. 108– 115.
- [7] Chu T.L., Shirley S. // Journal of Electr. Mater. 1990. V. 19. N 9.
- [8] Scavani C., Reddy K.T.R. // Semicond. Sci. and Technol. 1991. N 6. P. 1036-1040.